证券代码：688469　　证券简称：芯联集成　　公告编号：2024-076

芯联集成电路制造股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年11月5日（星期二）15:00-16:30

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 投资者可于2024年11月5日前访问网址https://eseb.cn/1iAM603T7Vu或使用微信扫描下方小程序进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月29日披露公司《2024年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况、发展战略等情况，公司定于2024年11月5日（星期二）15:00-16:30在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办芯联集成电路制造股份有限公司2024年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2024年11月5日（星期二）15:00-16:30

2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

3、会议召开方式：网络互动方式

三、参会人员：

公司出席本次说明会的人员：

董事长：丁国兴先生

董事、总经理：赵奇先生

财务负责人、董事会秘书：王韦先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参会方式

投资者可于2024年11月5日（星期二）15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1iAM603T7Vu或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年11月5日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张毅、商娴婷

联系电话：0575-88421800

联系邮箱：IR@unt-c.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：688469　　证券简称：芯联集成

芯联集成电路制造股份有限公司2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,667,849,497.31	27.16	4,547,418,766.97	18.68
归属于上市公司股东的净利润	-213,418,781.55	减亏15.46%	-684,175,637.03	减亏49.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-296,122,495.81	减亏34.56%	-1,073,645,724.50	减亏34.26%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,019,878,641.46	-48.29
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	536,479,435.35	18.08	1,659,789,019.92	92.65
基本每股收益(元/股)	-0.03	不适用	-0.10	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03	不适用	-0.10	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.80	不适用	-5.63	不适用
研发投入合计	482,755,257.98	23.22	1,352,021,798.87	29.79
研发投入占营业收入的比例(%)	28.94	减少0.92个百分点	29.73	增加2.54个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	33,061,109,110.82	31,570,366,445.66		4.72
归属于上市公司股东的所有者权益	11,971,604,124.39	12,483,074,709.70		-4.10

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	74,596,242.69	69,107,419.84	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10,688,773.60	322,866,197.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,962,398.69	-2,188,286.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	179,454.89	1,268,340.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)	798,358.23	1,583,583.67	
合计	82,703,714.26	389,470,087.47	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的、以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	减亏49.73%	报告期内，受益于新能源车及消费市场的回暖，公司产能利用率逐步提升。公司SiC MOSFET、12英寸硅基晶圆等新产品在头部客户快速导入和量产，以SiC MOSFET芯片及模组产线组成的第二增长曲线和以高压、大功率BCD工艺为主的模拟IC方向的第三增长曲线快速增长，公司营业收入快速上升。同时公司继续增强精益生产管理能力、供应链管理能力、成本控制能力等，大幅提升公司产品的市场竞争力。公司SiC MOSFET、12英寸产品的规模效益和技术优势逐渐显现，公司盈利能力趋于向好。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	减亏34.56%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	减亏34.26%	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-48.29	本期支付的增值税较上年同期增加
息税折旧摊销前利润(EBITDA)_年初至报告期末	92.65	1)因SiC MOSFET、12英寸硅基晶圆等新建产线快速上量，公司营收快速增长； 2)公司持续进行有效的成本控制及营收增长带来的规模效益，现金毛利持续向好。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	180,773				报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		
						股份状态	数量	
绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,152,000,000	16.33	1,152,000,000	1,152,000,000	无		
中芯国际控股有限公司	境内非国有法人	993,600,000	14.09	993,600,000	993,600,000	无		
绍兴硅芯锐企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	230,400,000	3.27	230,400,000	230,400,000	无		
绍兴日芯锐企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	216,000,000	3.06	216,000,000	216,000,000	质押	190,000,000	
宁波振芯股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	136,767,324	1.94	0	0	无		
共青城秋实股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	136,094,653	1.93	0	0	无		
共青城橙海股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	135,904,000	1.93	0	0	无		
宁波东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	108,000,000	1.53	0	0	无		
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	107,799,838	1.53	0	0	无		
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	境内非国有法人	103,409,673	1.47	0	0	无		
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宁波振芯股权投资合伙企业(有限合伙)	136,767,324	人民币普通股	136,767,324
共青城秋实股权投资合伙企业(有限合伙)	136,094,653	人民币普通股	136,094,653
共青城橙海股权投资合伙企业(有限合伙)	135,904,000	人民币普通股	135,904,000
宁波东鹏合立股权投资合伙企业(有限合伙)	108,000,000	人民币普通股	108,000,000
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	107,799,838	人民币普通股	107,799,838
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	103,409,673	人民币普通股	103,409,673
富诚海富通芯锐1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	100,193,321	人民币普通股	100,193,321
共青城橙芯股权投资合伙企业(有限合伙)	89,534,147	人民币普通股	89,534,147
MASTERWELL (HK) LIMITED	77,958,122	人民币普通股	77,958,122
青岛聚源芯越二期股权投资合伙企业(有限合伙)	77,586,250	人民币普通股	77,586,250
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、越城基金与青岛聚源芯越二期存在关联关系；2、中芯控股与青岛聚源芯越二期存在关联关系；3、硅芯锐、日芯锐存在关联关系；4、共青城橙海、共青城秋实、共青城橙芯存在关联关系； 除了上述股东关联关系外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

（1）公司回购事项进展情况：

2024年4月13日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在未来适宜时机用于股权激励计划及/或员工持股计划，回购价格不超过人民币7元/股（含）；回购资金总额不低于人民币20,000.00万元（含），不超过人民币40,000.00万元（含）；回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年4月15日、2024年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-022）、《芯联集成电路制造股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-029）。

公司于2024年5月14日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份4,918,982股，占公司总股本7,046,641,000股的比例为0.0698%，回购成交的最高价为4.08元/股，最低价为4.04元/股，支付的资金总额为人民币19,999,992.62元（不含交易佣金等交易费用）。详见公司于2024年5月15日披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份进展公告》（公告编号：2024-038）。根据相关规定，公司于2024年5月8日、6月4日、7月2日、7月4日、8月2日、9月3日披露了《芯联集成电路制造股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》。上述具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

截至2024年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份99,980,204股，占公司总股本的1.4174%，最高成交价为4.26元/股，最低成交价为3.47元/股，成交总金额为399,365,397.44元（不含交易费用），本次回购股份方案已实施完毕。

（2）关于发行股份及支付现金购买资产事项的进展：

2024年6月21日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。并于2024年6月22日披露了《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关文件。主要内容为公司拟发行股份及支付现金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等15名交易对方合计持有的芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司72.33%股权。

2024年9月4日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。并于2024年9月5日披露了《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件。

2024年9月20日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。

本次交易需经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可正式实施，后续公司将根据进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：芯联集成电路制造股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,748,588,028.26	3,995,220,464.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	-	50,370,000.34
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,175,708,713.97	550,294,845.42
应收款项融资	1,100,000.00	-
预付款项	167,521,782.58	145,743,117.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,568,495.14	21,912,970.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,271,021,414.80	1,983,769,298.46
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	636,348,704.83	290,339,202.48
流动资产合计	9,039,857,139.58	7,037,649,899.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	394,082,805.53	217,101,736.11
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	524,108,025.40	60,925,427.40
其他权益工具投资	60,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	67,668,647.59	69,637,873.79
固定资产	18,997,839,107.43	20,997,136,847.33
在建工程	2,132,020,337.44	1,252,287,367.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,973,058.21	35,111,937.50
无形资产	881,537,917.12	978,141,114.01
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	62,887,207.05	56,857,700.33
递延所得税资产		
其他非流动资产	880,134,865.47	815,516,542.01
非流动资产合计	24,021,251,971.24	24,532,716,545.82
资产总计	33,061,109,110.82	31,570,366,445.66
流动负债：		
短期借款	4,359,751,999.98	2,596,241,971.10
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	-	992,673.14
衍生金融负债		
应付票据	259,439,443.18	158,214,713.06
应付账款	2,409,699,914.27	2,762,871,594.56
预收款项		
合同负债	247,845,841.03	571,727,634.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	183,187,828.51	139,656,094.54
应交税费	32,984,136.26	34,871,869.46
其他应付款	15,691,967.27	24,545,722.25
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	574,189,834.87	453,680,107.51
其他流动负债	25,456,970.73	66,327,044.96
流动负债合计	8,108,247,936.10	6,809,129,425.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,304,942,103.71	6,718,717,801.43
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,707,413.52	16,430,872.42
长期应付款	-	1,512,591,888.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	781,448,466.61	665,117,481.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,091,097,983.84	8,912,858,044.59
负债合计	16,199,345,919.94	15,721,987,469.96
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	7,053,657,113.00	7,044,602,275.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,043,438,013.76	9,480,395,743.13
减：库存股	399,392,056.91	-
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-4,726,098,945.46	-4,041,923,308.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,971,604,124.39	12,483,074,709.70
少数股东权益	4,890,159,066.49	3,365,304,266.00
所有者权益(或股东权益)合计	16,861,763,190.88	15,848,378,975.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	33,061,109,110.82	31,570,366,445.66

公司负责人：赵奇　　主管会计工作负责人：王韦　　会计机构负责人：张毅

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：芯联集成电路制造股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,547,418,766.97	3,831,546,831.51
其中：营业收入	4,547,418,766.97	3,831,546,831.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,309,094,941.16	5,394,055,474.10
其中：营业成本	4,567,034,907.45	3,968,092,754.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,216,826.91	25,365,410.36
销售费用	29,682,743.15	20,551,459.64
管理费用	102,882,308.43	85,740,748.92
研发费用	1,352,021,798.87	1,041,674,134.15
财务费用	226,256,356.35	252,630,966.27
其中：利息费用	282,788,915.33	359,652,845.32
利息收入	75,452,815.52	90,681,497.96
加：其他收益	784,427,291.84	322,432,469.73
投资收益(损失以"-"号填列)	5,101,590.25	18,295,524.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,121,942.00	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,396,836.78	40,148,079.56
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-161,756.67	-152,530.82
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-748,659,778.53	-818,821,487.64
资产处置收益(损失以"-"号填列)	69,107,419.84	26,747,745.74
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,649,464,570.68	-1,973,858,841.62
加：营业外收入	1,477,939.36	487,144.35
减：营业外支出	209,598.90	165,387.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,648,196,230.22	-1,973,537,084.78
减：所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,648,196,230.22	-1,973,537,084.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,648,196,230.22	-1,973,537,084.78
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-684,175,637.03	-1,361,009,649.55
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-964,020,593.19	-612,527,435.23
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,648,196,230.22	-1,973,537,084.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-684,175,637.03	-1,361,009,649.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-964,020,593.19	-612,527,435.23
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.23
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：赵奇　　主管会计工作负责人：王韦　　会计机构负责人：张毅

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：芯联集成电路制造股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,248,238,001.10	4,400,986,551.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	589,073,982.88	1,260,660,249.56
收到其他与经营活动有关的现金	755,947,313.54	743,456,741.89
经营活动现金流入小计	5,593,259,297.52	6,405,103,543.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,684,948,570.06	3,343,163,197.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,018,980,455.40	896,706,216.05
支付的各项税费	748,662,848.88	30,097,326.74
支付其他与经营活动有关的现金	120,788,781.72	162,744,351.33
经营活动现金流出小计	4,573,380,656.06	4,432,711,091.78
经营活动产生的现金流量净额	1,019,878,641.46	1,972,392,451.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,960,806.28	16,210,955.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,013,162.35	31,505,689.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,450,875,301.95	2,891,454,043.09
投资活动现金流入小计	1,469,849,270.58	2,939,170,688.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,799,450,210.83	8,682,520,612.52
投资支付的现金	481,304,540.00	51,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,471,006,549.86	2,301,432,497.94
投资活动现金流出小计	4,751,761,300.69	11,034,953,110.46
投资活动产生的现金流量净额	-3,281,912,030.11	-8,095,782,422.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,016,005,749.64	11,623,637,534.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,990,833,300.00	750,000,000.00
取得借款收到的现金	9,457,816,115.54	5,549,165,502.67
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	12,473,821,865.18	18,672,803,037.33
偿还债务支付的现金	7,155,881,300.70	9,166,560,177.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,861,238.77	336,167,421.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,937,505,106.06	53,362,116.75
筹资活动现金流出小计	9,369,247,645.53	9,556,089,716.29
筹资活动产生的现金流量净额	3,104,574,219.65	9,116,713,321.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,680,906.51	-17,100,378.36
五、现金及现金等价物净增加额	823,859,924.49	2,976,222,971.75
加：期初现金及现金等价物余额	3,905,228,103.77	1,620,371,201.56
六、期末现金及现金等价物余额	4,729,088,028.26	4,596,594,173.31

公司负责人：赵奇　　主管会计工作负责人：王韦　　会计机构负责人：张毅

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：688469　　证券简称：芯联集成　　公告编号：2024-077

芯联集成电路制造股份有限公司关于董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会及修订相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会及修订相关工作细则的议案》。现将相关事项公告如下：

为适应公司发展战略需要，确保规划的合理性与投资决策的科学性，推进公司环境、社会与公司治理工作，提升公司可持续发展能力，完善公司治理结构，经研究，将董事会下设的"战略委员会"更名为"战略与可持续发展委员会"，并将原《芯联集成电路制造股份有限公司董事会战略委员会工作细则》更名为《芯联集成电路制造股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职责基础上增加相应可持续发展管理职责等内容，修订该委员会的议事规则部分条款，详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯联集成电路制造股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：688469　　证券简称：芯联集成　　公告编号：2024-075

芯联集成电路制造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币20亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、可转让大额存单、通知存款、收益权凭证等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在授权额度范围内，董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了明确的同意意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月13日出具的《关于同意绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕548号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股169,200.00万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币5.69元，募集资金总额为人民币962,748.00万元（行使超额配售选择权之前），扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币937,276.55万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月5日出具了《验资报告》（天职业字[2023]33264号），验证募集资金已全部到位。

2023年6月8日，保荐人海通证券股份有限公司（主承销商）全额行使超额配售选择权，公司在初始发行169,200.00万股普通股的基础上额外发行25,380.00万股普通股，由此增加的募集资金总额为144,412.20万元，扣除发行费用（不含增值税）3,347.05万元，超额配售募集资金净额为141,065.15万元。保荐机构（主承销商）已于2023年6月9日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金扣除承销费用（不含增值税）后划付给公司。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于2023年6月9日出具了《验资报告》（天职业字[2023]35399号）。

全额行使超额配售选择权后，公司在初始发行169,200.00万股普通股的基础上额外发行25,380.00万股普通股，故本次发行最终募集资金总额为1,107,160.20万元。扣除发行费用28,818.50万元，募集资金净额为1,078,341.70万元。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2023-019）以及《芯联集成电路制造股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-009）。

二、募集资金投资项目情况

根据《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资计划，公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议根据实际募集资金净额对公司募投项目使用募集资金投资金额进行的调整，以及公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议、第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议基于新增募投项目，对公司募投项目使用募集资金投资金额进行的调整，调整后的募集资金使用计划如下：

单位：亿元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金总额
1	MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目	65.64	-
2	二期晶圆制造项目	110.00	16.60
3	中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目	42.00	22.10
4	三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目	180.00	27.90
5	补充流动资金	43.40	41.23
合计		441.04	107.83

根据《芯联集成电路制造股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，扣除发行费用后募集资金净额为1,078,341.70万元，截止2024年6月30日，公司累计投入募投项目的募集资金总额852,150.23万元，累计投入进度为79.02%，募集资金专户余额为227,824.66万元。根据目前项目进展，该剩余部分募集资金预计在2025年内使用完毕。随着银行LPR逐渐降低，公